

利用課題番号 : F-13-WS-0059
利用形態 : 技術相談
利用課題名 (日本語) : 基板の貼合せ封止・実装技術
Program Title (English) : Substrates bonding and packaging technology
利用者名 (日本語) : 江面知彦¹⁾
Username (English) : T. Edura¹⁾
所属名 (日本語) : 1) 九州大学最先端有機光エレクトロニクス研究センター
Affiliation (English) : 1) OPERA, Kyushu University

1. 概要 (Summary) :

水、酸素等に対して劣化しやすい有機系材料薄膜を外部環境から隔離するためのパッケージ方法について相談した。

紫外線硬化樹脂を使用した貼り付けに関する固定技術や、貼り合せを行う雰囲気化を不活性液体で満たすための注入技術などの各種の要素技術について、上述の最適な方法、プロセスについて議論し、実施可能ないくつかのアドバイスを頂いた。

2. 実験 (Experimental) :

なし。

3. 結果と考察 (Results and Discussion) :

なし。

4. その他・特記事項 (Others) :

なし。

5. 論文・学会発表 (Publication/Presentation) :

なし。

6. 関連特許 (Patent) :

なし。